

有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2047号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为187,143,158股。其中初始战略配售发行数量为56,142,947股，约占本次发行数量的30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为40,546,007股，约占本次发行数量的21.67%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15,596,940股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为120,397,151股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.13%；网上初始发行数量为26,200,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.87%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币9.91元/股。

发行人于2022年11月1日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“有研硅”股票2,620.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年11月3日（T+2日）

及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格 9.91 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，资金应于 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在 2022 年 11 月 4 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自

结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,176,758 户，有效申购股数为 74,465,455,500 股，网上发行初步中签率为 0.03518410%。

配号总数为 148,930,911 个，号码范围为 100,000,000,000-100,148,930,910。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,842.19 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 14,660,000 股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 105,737,151 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.13%；网上最终发行数量 40,860,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.87%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05487108%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2022 年 11 月 2 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：有研半导体硅材料股份公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022 年 11 月 2 日

（此页无正文，为《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：有研半导体硅材料股份公司



2022年11月2日

（此页无正文，为《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022 年 11 月 2 日